知財様式２

令和　　年　　月　　日

国立研究開発法人科学技術振興機構　殿

（機関名）

（部署・職名）

（氏名）　　　　　　　　　　　　　役職印

≪契約調印者、又は知的財産権について出願・譲渡等の権限を持つ者≫

知的財産権実施通知書

委託研究の成果に係る知的財産権の実施について、以下のとおり通知します。

１．本通知に係る委託研究の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  |
| 研究タイプ |  |
| 研究領域もしくはプログラム名（ない場合は「なし」と記載） |  |
| 研究題目もしくは研究開発課題名 |  |
| 契約番号もしくは課題番号 |  |
| 研究（開発）担当者及び所属・職名(研究実施当時) |  |
| 研究（開発）期間 | 年　月　日　～　年　月　日 |

※　事業名、研究タイプ、研究領域もしくはプログラム名等は委託研究契約書に記載の名称を記載してください。

※　契約番号もしくは課題番号は、直近のものを記載してください。契約番号が付与されていない契約は記載不要です。

２．対象となる知的財産権について

|  |  |
| --- | --- |
| 知的財産権の種類（注１） |  |
| 発明等の名称（注２） |  |
| 設定登録番号又は出願番号等（注３） |  |

３．実施等について

|  |  |
| --- | --- |
| 実施 | 自己、第三者＊（通常実施権・専用実施権等）　（注４） |
| 特記事項（注５） |  |

※第三者は実施許諾した場合

|  |
| --- |
| （注意事項） |
| （注１） | 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権又は著作権のうち、該当するものを記載してください。 |
| （注２） | 該当する①～④の事項を記載してください。①　発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称②　回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類（構造、技術、機能）③　植物体の品種については、農林水産植物の種類（属、種、亜種）、出願品種の名称④　著作権については、著作物の名称 |
| （注３） | 番号については、当該種類に係る設定登録番号、設定登録の出願又は申請番号もしくは著作物の登録番号又は管理番号を記載してください。 |
| （注４） | 自己又は第三者のいずれか（両方の場合は２つとも）を○で囲んでください。 |
| （注５） | 産業技術力強化法施行令第２条第３号に該当する専用実施権等の設定等の場合における事前申請の　例外となった根拠や実施の状況の変化（実施を中止した場合等）について記載してください。 |

≪制度固有の取扱い ①：ＳＩＰ／ＳＩＰ２≫

・戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ／ＳＩＰ２）については、第三者に対し、通常実施権の許諾及び専用実施権等の設定等を行う場合は、産業技術力強化法施行令第２条第３号に該当する場合であっても例外なく知財様式４による事前申請が必要となります。

≪制度固有の取扱い ②：産学共創基礎基盤研究プログラム≫

・産学共創基礎基盤研究プログラムは（注５）の事前申請の例外となった根拠の記載は不要です。